

SiPaste® 3.2HF 细间距系统级封装 (SiP) 水洗型焊锡膏

- 优异的印刷性 (5、6、7号粉)
- 钢网寿命长
- 出色的暂停响应性能
- 抗坍塌
- 可焊性佳

SiPaste® C201HF 超细间距系统级封装可清洗型焊锡膏

- 回流后的残留物是良性的，可用市场上常见的水基、半水基清洗剂清洗
- 即使超低间隙或超细间距元件下的残留，仍能轻松去除
- 钢网寿命长
- 润湿能力强
- 出色的暂停响应性能

主要应用场景

- 前端模组系统级封装

>2,000,000,000
超20亿颗系统级封装使用

联系我们的工程师：**Sze Pei Lim or Evan Griffith**
更多：www.indium.com

所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证
钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

